

# MEMORIAL DESCRITIVO

NÚMERO DE REFERÊNCIA: XXX/2023	EMITIDO EM: xx/xx/2023
NOME COMERCIAL DO EQUIPAMENTO: HESSE BONDJET. PN: BJ820	

## Descrição do equipamento:

Micro soldadora de fio fino totalmente automático de alta velocidade. Este equipamento utiliza fios e fitas feitas de alumínio, cobre e ouro. As aplicações típicas são componentes na tecnologia HF e RF, COB, MCM e híbridos, optoeletrônica e eletrônica automotiva.

Possui monitoramento contínuo em tempo real da deformação do fio/fita. Possui uma área de trabalho de 305 mm x 410 mm.

## Especificações:

Nome comercial	Parallel Seam Sealer System
NCM	8515.80.90
Fabricante / Marca	Hesse Mechatronics.
Modelo	Bondjet BJ820
País de origem	
Altura	1.800 mm.
Largura	722 mm.
Comprimento	1.250 mm.
Peso	~ 1.350 kg.
Tensão de alimentação	230 VAC – 50/60 Hz.

## Composição do equipamento:

O equipamento é composto por uma peça, figura 1. Possui conexões para ar comprimido (alta pureza) e para vácuo. Assim como entradas para E/S digitais e portas USB.

Possui cabeçotes (bondhead) de 45°, 60° e 90° (acesso profundo) que podem ser substituídos em minutos.

## Fotos do equipamento:



*Figura 1.- Wire bonder. Parte frontal*